

“电子电镀技术”专题征稿函

21 世纪，随着现代科学技术的飞速发展，人类进入一个崭新的时代——信息时代。随着微型计算机、通信、家电等电子产品产业的发展和普及，对电子产品加工技术要求越来越高，电子电镀技术得到了前所未有的重视。

电子电镀是电子产品制造加工的重要环节，在很大程度上体现了电子制造业的技术水平。由于电子电镀面对的是高技术含量的电子领域，与常规的装饰、防护性电镀相比，在种类、功能、精度、质量和电镀方法等方面均有不同，技术要求非常高，在某种意义上电子电镀已成为一门独立于常规电镀的专门技术。基于此，本刊近期计划策划“电子电镀技术”专题，由**哈尔滨工业大学李宁教授**担任专题主编。李教授是中国表面工程协会特种涂层委员会副理事长、中国腐蚀与防护学会常务理事。本专题文章可以是研究快报、技术论文或结合本课题组重要成果的前沿领域综述等。专题内容主要包括：

印制板(PCB)表面涂覆工艺；塑料电镀、直接电镀技术；连接器、接插件、微波器件电镀；电子、微电子器件表面处理技术；纳米电镀、脉冲电镀等新型镀层加工方法；绿色环保电镀技术；其它您认为本领域有意义的问题。

本刊编辑部及**李宁教授**特邀您撰稿，展示您的研究成果与学术发现，以期进一步提升该专题的学术质量和影响力。请在**2017年1月31日**前投稿。我们将快速处理，并优先为您在正刊上发表，《表面技术》目前为全国中文核心期刊、中国科学引文数据库（CSCD）来源期刊。

投稿方式：登陆本刊网站 www.surface-techj.com 上注册并进行网上投稿，投稿栏目请选择“**电子电镀技术**”专题。

电话：023-68792193

传真：023-68792396

网址：www.surface-techj.com

Email：wjqkbm@163.com

通讯地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路 33 号 邮编：400039

